

SEMICON Japan 2023

出展のお知らせ

ごあいさつ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、日揮グローバル株式会社は、来る12月13日(水)から東京ビッグサイトにおいて開催されます「SEMICON Japan 2023」に出展いたします。

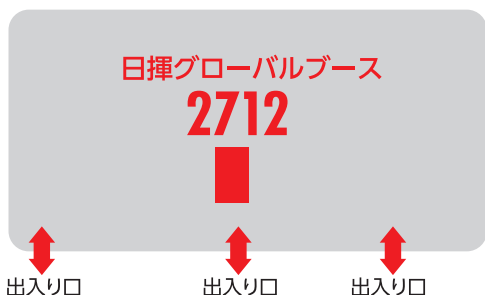
つきましては、期間中ご多忙のことと存じ上げますが、何卒ご高覧賜ります様ご案内申し上げます。

敬具

JGC 日揮グローバル株式会社

海外進出のパートナー 総合エンジニアリングのJGC

東2ホール



SEMICON[®]
JAPAN

会期 2023年12月13日(水)～12月15日(金)

時間 10:00～17:00

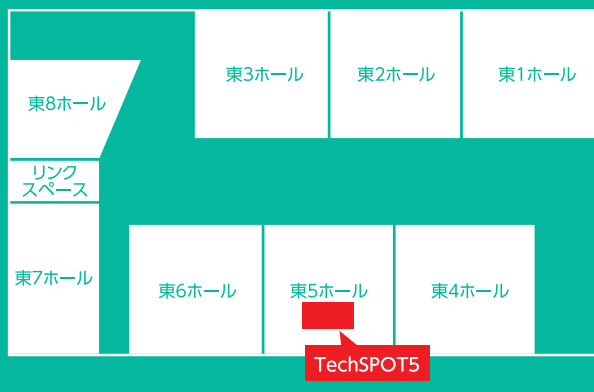
会場 東京ビッグサイト(東2ホール)

弊社出展小間:No.2712

日揮グループは創業以来、石油精製・天然ガスから化学品、医薬品まで様々な分野のプラント・工場のEPC(設計・調達・建設)に携わってきました。これらの分野で培ってきたエンジニアリング力とプロジェクト遂行力を活かし、半導体分野における工場の基本構想やEPCに注力しています。以下の日程で開催する「EXHIBITOR'S TechSPOT Hall5」のセミナーでは、当社の半導体分野での取り組み実績や環境負荷低減等の技術ソリューション、確実なプロジェクト遂行などについてご紹介します。是非ご来場いただきますようお願い申し上げます。

EXHIBITOR'S TechSPOT Hall5

- テーマ：半導体分野における日揮グローバル株式会社の取り組み
- 日時：①12月13日(水) 14:30～14:50
②12月14日(木) 14:30～14:50
- 場所：東5ホール TechSPOT Hall5
- 登壇者：日揮グローバル株式会社 執行役員
ファシリティソリューションズ プレジデント
野平 啓二



お問い合わせ

日揮グローバル株式会社 ファシリティソリューションズ 営業部

TEL:045-682-8062 E-mail:facilitysolutions_sales@jgc.com